# Эпитаксиальная комбинация NdBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7 $-\delta$ </sub>/SrTiO<sub>3</sub>: особенности роста, структура и параметры

© Ю.А. Бойков, В.А. Данилов, Т. Клаесон\*, Д. Эртс\*\*

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, 194021 Санкт-Петербург, Россия \* Чалмерский технический университет, S-41296 Гетеборг, Швеция \*\* Институт химической физики, Университет Латвии, 1586 Рига, Латвия

(Поступила в Редакцию 6 июля 1998 г.)

Исследованы особенности роста, структура и параметры эпитаксиальных гетероструктур (001)NdBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>/(100)SrTiO<sub>3</sub>/(001)NdBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>, выращенных методом лазерного испарения на подложке (100)LaAlO<sub>3</sub> с тонкой ( $\sim 2 \, \text{nm}$ ) прослойкой YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>. Использование прослойки УВа2Си3О7-6 способствует послойному росту пленки (200 nm)NdBa2Cu3O7-6, шероховатость свободной поверхности которой составляет 4-5 nm. Резкое падение сопротивления пленок NdBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> начиналось при  $T = 92 \,\mathrm{K}$ , а при  $T \approx 87 \,\mathrm{K}$  оно обращалось в нуль. Плотность критического тока в пленках NdBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> при T = 76 K превышала 10<sup>6</sup> A/cm<sup>2</sup>. Диэлектрическая проницаемость слоя (400 nm)SrTiO<sub>3</sub>, введенного между эпитаксиальными пленками NdBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub>, возрастала примерно в 3 раза при понижении температуры в интервале 300-4.2 К. При подаче на электроды NdBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> напряжения смещения ±2.5 V относительная диэлектрическая проницаемость промежуточного слоя (400 nm)SrTiO<sub>3</sub> понижалась от 1150 до 400 ( $T = 32 \,\mathrm{K}, f = 100 \,\mathrm{kHz}$ ). Проводимость промежуточного слоя SrTiO<sub>3</sub> в направлении, перпендикулярном плоскости подложки, возрастала с температурой и напряженностью электрического поля.

Эпитаксиальные пленки RBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> (R — редкоземельный элемент), выращенные на монокристаллических подложках из материалов с низкой диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon$  и низкими диэлектрическими потерями tg  $\delta$ , были успешно использованы при формировании пассивных элементов для диапазона CBЧ, в частности узкополосных фильтров с рабочей частотой в десятки GHz [1,2]. В настоящее время активно проводятся исследования и разработки с целью создания на основе эпитаксиальной комбинации сверхпроводник/сегнетоэлектрик перенастраиваемых элементов CBЧ-техники: фазовращателей, фильтров, варакторных структур и т.д. [3,4].

Варьирование параметров СВЧ-элемента, сформированного на основе гетероструктуры сверхпроводник/сегнетоэлектрик, обеспечивается за счет контролируемого изменения диэлектрической проницаемости слоя сегнетоэлектрика под действием электрического поля. Существенная зависимость  $\varepsilon$  от напряженности электрического поля *E* для объемных монокристаллов сегнетоэлектрических материалов наблюдается, как правило, при температурах, близких к температуре фазового перехода [5]. Основными кандидатами среди сегнетоэлектриков для использования в эпитаксиальной комбинации с пленками RBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> являются (Ba,Sr)TiO<sub>3</sub> и KTaO<sub>3</sub> [6,7].

Параметры тонкого сегнетоэлектрического слоя, введенного в многослойную эпитаксиальную гетероструктуру на основе пленок  $RBa_2Cu_3O_{7-\delta}$ , существенно отличаются от данных для соответствующих объемных образцов. Основными причинами деградации  $\varepsilon$  и резкого возрастания tg  $\delta$  в тонких слоях (Ba,Sr)TiO<sub>3</sub> и KTaO<sub>3</sub> по сравнению с соответствующими монокристаллами являются высокая плотность дефектов структуры в их объеме и нарушение стехиометрии в области межфазных границ.

Пленки NdBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> (NBCO) привлекательны для использования в элементах CBЧ-техники и сверхпроводниковой микроэлектроники, поскольку 1) наивысшая температура сверхпроводящего перехода  $T_c \approx 97 \text{ K}$  в сверхпроводниках RBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> достигается при R  $\equiv$  Nd [8]; 2) эпитаксиальные пленки NBCO имеют гладкую свободную поверхность [9]; 3) нейтрализация вакансий Ва в пленке NBCO ионами Nd должна приводить к подавлению диффузионных потоков между слоями, составляющими эпитаксиальную гетероструктуру сверхпроводник/сегнетоэлектрик, так как именно барий способен активно диффундировать из пленки сверхпроводника [10].

В литературе не было найдено данных по диэлектрическим свойствам тонких слоев (Ba,Sr)TiO<sub>3</sub> в комбинации с электродами из NBCO. Согласно [9], для выращивания четко с-ориентированных пленок NBCO температуру подложки  $T_s$  при конденсации паровой фазы, образующейся в процессе лазерного испарения исходной шихты, необходимо повышать до 840°C.

В данной работе исследована возможность реализации послойного роста пленки (001)NBCO при  $T_s$  и давлении кислорода, используемых для выращивания эпитаксиальных пленок SrTiO<sub>3</sub> (STO). Сформированы и исследованы трехслойные эпитаксиальные гетероструктуры (001)NBCO/(100)STO/(001)NBCO.

#### 1. Эксперимент

Для выращивания пленок NBCO, УВа<sub>2</sub>Си<sub>3</sub>О<sub>7-б</sub> (УВСО) и STO был использован метод лазерного испарения (KrF,  $\lambda = 248$  nm,  $\tau = 30$  ns). Пленки NBCO И трехслойные гетероструктуры NBCO/STO/NBCO выращивались подложках на (100)LaAlO<sub>3</sub> (5 × 5 × 0.5 mm). Промежуточный слой STO в гетероструктурах имел толщину  $d = 400 \,\mathrm{nm}$ , а толщина пленок сверхпроводника равнялась 200 nm. В качестве исходных мишеней использовались поликристаллические шайбы NBCO, YBCO и STO стехиометрического состава, приготовленные по стандартной керамической технологии. Испарение мишеней проводилось в атмосфере кислорода  $P_{\Omega} = 0.3$  mbar.  $T_s$  в процессе выращивания пленок сверхпроводника и тонких слоев титаната стронция равнялась 780°С. Плотность лазерного излучения на поверхности мишени при выращивании пленок NBCO, YBCO и STO равнялась 1.5 J/cm<sup>2</sup>.

Чтобы сформировать на подложке ступени высотой  $\sim 1.2$  nm, на поверхности (100)LaAlO<sub>3</sub> непосредственно перед началом формирования пленки NBCO выращивалась прослойка (001)YBCO толщиной 2 nm.

Контроль за структурой и составом сформированных пленок NBCO и гетероструктур NBCO/STO/NBCO осуществлялся с использованием рентгеновских дифрактометров Philips PW 1710 ( $\theta/2\theta$ -сканирование) и Siemens D 5000 ( $\phi$ -сканирование).

Морфология поверхности сформированных пленок NBCO толщиной 2–200 nm, слоя STO, выращенного на поверхности (200 nm)NBCO/(2 nm)YBCO/LaAlO<sub>3</sub>, и верхней пленки NBCO в трехслойной гетероструктуре (200 nm)NBCO/(400 nm)STO/(200 nm)NBCO исследовалась с использованием микроскопа атомных сил NanoScope-IIIa.

 $T_c$  для пленок NBCO определялась из температурных зависимостей сопротивления R и магнитной восприимчивости  $\chi$ . Плотность критического тока  $J_c$  измерялась на микромостиках шириной 4  $\mu$ m и длиной 25  $\mu$ m, сформированных в пленках NBCO с использованием фотолитографии и ионного травления (Ar, 500 V, 0.2 mA).

Для измерения  $\varepsilon$ , проводимости *G* и tg  $\delta$  для слоя STO, введенного между двумя эпитаксиальными пленками NBCO, были сформированы плоскопараллельные конденсаторные структуры, в качестве общего электрода в которых использовалась нижняя пленка NBCO.



**Рис. 1.** *а*) Морфология поверхности пленки (001)NBCO толщиной 200 nm, выращенной на (2 nm)YBCO/(100)LaAlO<sub>3</sub>. На изображении четко видны кристаллиты из четырех верхних слоев сверхпроводника толщиной ~ 1.2 nm: *1* — сформировавшийся кристаллит из верхнего слоя сверхпроводника, *2* — изолированные кристаллиты из нижележащего слоя сверхпроводника, *3* — кристаллиты, образующие сплошную сетку в третьем слое сверхпроводника, *4* — изолированные незаросшие "окна" в четвертом слое сверхпроводника. *b*) Морфология поверхности слоя (100)STO толщиной 400 nm, выращенного на (200 nm)NBCO/(2 nm)YBCO/(100)LaAlO<sub>3</sub>. *c*) Морфология поверхности пленки NBCO толщиной 200 nm, выращенной на (400 nm)STO/(200 nm)NBCO/(2 nm)YBCO/(100)LaAlO<sub>3</sub>: *1* — микроотверстия в слое сверхпроводника, *2* — **а**-ориентированные частицы.



Рис. 1 (продолжение).



**Рис. 2.** Дифрактограмма ( $\theta/2\theta$ , Си  $K_{\alpha}$ ) для трехслойной гетероструктуры (200 nm)NBCO/(400 nm)STO/(200 nm)NBCO, выращенной на подложке (100)LaAlO<sub>3</sub> с прослойкой (2 nm)YBCO. I — рефлексы Си  $K_{\alpha}$  от подложки, II — рефлексы Си  $K_{\beta}$  от подложки. На вставке — тонкая структура рентгеновского пика при  $2\theta \approx 46.5^{\circ}$ : 1 - (006)NBCO-рефлекс от нижней пленки сверхпроводника, 2 - (200)STO-рефлекс, 3 - (006)NBCO-рефлекс от верхней пленки сверхпроводника, 4 - (200)NBCO-рефлекс от **а**-ориентированных зерен в верхней пленке сверхпроводника.

Для формирования верхних электродов с площадью  $S = 35 \cdot 10^3 \,\mu\text{m}^2$  в пленке NBCO, выращенной на поверхности слоя STO, были использованы фотолитография и ионное травление. Измерение емкости *C*, *G* и tg  $\delta$  проводилось для слоев STO в интервале температур 4.2–300 K с использованием HP 4263A LCR meter ( $f = 0.1-100 \,\text{kHz}$ ). Диэлектрические параметры STO измерялись как при подаче на электроды NBCO напряжения смещения  $V_b = \pm 2.5 \,\text{V}$ , так и без него. Положительным напряжение смещения считалось в том случае, когда на верхний электрод подавался +. Эффективная диэлектрическая проницаемость слоя сегнетоэлектрика рассчитывалась с использованием соотношения  $\varepsilon = Cd/S$ .

## 2. Результаты

Несмотря на то что все купратные сверхпроводники группы  $RBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  изоморфны по структуре, морфология поверхности пленок NBCO толщиной 2–10 nm существенно отличалась от морфологии поверхности тонких пленок YBCO. На поверхности пленок YBCO толщиной 2–10 nm, выращенных на (100)LaAlO<sub>3</sub>, имелись

ступени высотой ~ 1.2 nm, между которыми располагались плоские участки, присутствия а-ориентированных зерен (зерна, для которых ось с параллельна плоскости подложки) и микровключений вторичных фаз обнаружено не было. Вследствие присутствия а-ориентированных зерен, плотность которых достигала  $10^9 \, \text{cm}^2$ , а высота — 5 nm, поверхность пленок NBCO толщиной d = 2-10 nm была неровной. Исключить появление а-ориентированных зерен в пленке NBCO как на начальной стадии ее формирования, так и в процессе последующего роста ( $d \leq 200 \, \mathrm{nm}$ ) удалось при использовании в качестве подложки пластин (100)LaAlO<sub>3</sub> с выращенным на их поверхности слоем ҮВСО толщиной 2 nm. На полученных изображениях поверхности пленок NBCO ( $d = 200 \, \text{nm}$ ), выращенных на (2 nm)YBCO/LaAlO<sub>3</sub>, видны кристаллиты лишь из 3-4 верхних слоев пленки, толщина которых равна параметру c в NBCO (рис. 1, a). Спирали роста и а-ориентированные зерна при исследовании поверхности пленок (200 nm)NBCO/(2 nm)YBCO/LaAlO<sub>3</sub> обнаружены не были. Шероховатость свободной поверхности пленок (200 nm)NBCO, выращенных на (2 nm)YBCO/LaAlO<sub>3</sub>, составляла 4–5 nm.



**Рис. 3.** Температурные зависимости сопротивления R(1) и плотности критического тока  $J_c(2)$  для пленки (200 nm)NBCO, выращенной на подложке (2 nm)YBCO/(100)LaAlO<sub>3</sub>. На вставке — изменение с температурой магнитной восприимчивости  $\chi$  для трехслойной гетероструктуры (200 nm)NBCO/(400 nm)STO/(200 nm)NBCO.

При исследовании поверхности пленок (400 nm)STO, выращенных на (200 nm)NBCO/(2 nm)YBCO/LaAlO<sub>3</sub>, не было обнаружено отверстий, пронизывающих насквозь слой сегнетоэлектрика (рис. 1, b).

На поверхности верхней пленки NBCO в трехслойной системе NBCO/STO/NBCO имелись пирамидальные образования с характерными ступенями роста высотой 1.2 nm. На вершине указанных образований имелся плоский участок, что существенно отличало их от спиралей роста, в ядре которых располагается винтовая дислокация. С помощью микроскопа атомных сил на поверхности верхнего слоя NBCO были обнаружены отдельные слабо развитые **a**-ориентированные зерна (см. рис. 1, *b* и вставку к рис. 2). В пленке сверхпроводника имелись также отверстия, плотность которых достигала  $10^8 \text{ cm}^{-2}$  (рис. 1, *c*).

Рентгеновское исследование трехслойных гетероструктур NBCO/STO/NBCO, выращенных на (2 nm)YBCO/LaAlO<sub>3</sub>, показало, что пленки и промежуточный слой сверхпроводника сегнетоэлектрика были выращены эпитаксиально, причем (001)[010]NBCO || (100)[010]STO (рис. 2). Введение между подложкой LaAlO<sub>3</sub> и пленкой NBCO тонкой прослойки (2 nm)YBCO приводило к резкому сужению рентгеновских пиков и увеличению параметра c (см. вставку a на рис. 4). Параметр c для нижней и верхней пленок NBCO в гетероструктуре NBCO/STO/NBCO имел значения 11.79 и 11.75 Å соответственно, а параметр a = 3.905 Å кубической элементарной ячейки промежуточного слоя STO практически совпадал с данными для объемных монокристаллов титаната стронция при T = 300 K [11]. Данные по азимутальной ориентации слоев в гетероструктуре на основе пленок NBCO и слоя (Ba,Sr)TiO<sub>3</sub> приведены в [12].

Температурные зависимости сопротивления R и плотности критического тока  $J_c$  для пленки (001)NBCO толщиной d = 200 nm приведены на рис. 3. Изменение эффективной магнитной восприимчивости  $\chi$  с температурой для трехслойной гетероструктуры NBCO/STO/NBCO показано на вставке к рис. 3.

Отношение  $\varepsilon / \varepsilon_0$  ( $\varepsilon_0$  — диэлектрическая проницаемость вакуума) для слоя STO, помещенного между



**Рис. 4.** Температурные зависимости  $\varepsilon/\varepsilon_0(1)$  и tg  $\delta(2)$  для слоя STO толщиной 400 nm в трехслойной гетероструктуре (001)NBCO || (100)STO || (001)NBCO (f = 100 kHz). На вставке *a* приведены ренгтеновские пики (005) ( $\theta/2\theta$ , Cu  $K_\alpha$ ) для пленок (200 nm)NBCO, выращенных на (100)LaAlO<sub>3</sub> (1) и на (2 nm)YBCO/(100)LaAlO<sub>3</sub> (2). На вставке *b* показан максимум на зависимости  $\varepsilon/\varepsilon_0(V_b)$  для пленки (400 nm)STO в гетероструктуре (001)NBCO || (100)STO || (001)NBCO, сдвинутый относительно точки  $V_b = 0$  в сторону отрицательных значений напряжения смещения.

электродами из NBCO, возрастало от 320 до 1150 при понижении температуры в интервале 300-4.2 K (рис. 4). tg  $\delta$  для слоя сегнетоэлектрика при 4.2 < T < 150 Kслабо зависел от температуры и имел значения ~ 0.02 (f = 100 kHz), а при T > 200 K резко возрастал с увеличением T. Значение  $\varepsilon$  для слоя STO понижалось примерно втрое при подаче на сверхпроводниковые электроды напряжения смещения  $V_b = \pm 2.5 \text{ V}$  (T = 32 K) (рис. 5). С увеличением напряженности внешнего электрического поля E проводимость слоя сегнетоэлектрика в направлении, перпендикулярном плоскости подложки, возрастала пропорционально  $E^{1/2}$ .

# Обсуждение полученных результатов

Результаты исследования морфологии поверхности тонких пленок YBCO и NBCO и имеющиеся в литературе данные [13] по формированию кристаллической фазы на начальной стадии роста пленок указанных материалов, полученные с использованием дифракции быстрых электронов, позволяют говорить о том, что замена в купратном сверхпроводнике  $RBa_2Cu_3O_{7-\delta}$  ионов  $Y^{+3}$  на ионы  $Nd^{+3}$ , имеющие примерно на 11% больший ионный радиус [14], существенным образом сказывается на процессе зародышеобразования.

Низкие значения свободной энергии поверхности для плоскостей (001) являются движущей силой формирования стабильных зародышей YBCO, преимущественно ориентированных осью с перпендикулярно плоскости подложки [15], даже при использовании в качестве подложки материалов с большой разницей в параметрах кристаллических решеток. Именно анизотропия в свободной энергии поверхности и в скорости роста позволяет реализовать послойный рост пленок YBCO на подложках с малой разницей в параметрах кристаллических решеток при условии высокой подвижности адсорбированных частиц. Изменение свободной энергии Гиббса  $G_N$  для



**Puc. 5.** Зависимости  $ε/ε_0$  (1–5) и G(6-9) от напряженности внешнего электрического поля для слоя STO толщиной 400 nm в трехслойной гетероструктуре (001)NBCO || (100)STO || (001)NBCO (f = 100 kHz) при различных температурах. T (K): I, 6 - 32, 2, 7 - 75, 3, 8 - 112, 4, 9 - 178; 5 - зависимость  $ε/ε_0$  от E при T = 32 K, рассчитанная с использованием соотношения (2) для  $\xi = 1.2 \cdot 10^{10} \text{ F}^{-3} \cdot \text{m}^5 \cdot \text{V}^{-2}$ .

системы паровая фаза-подложка при формировании на поверхности подложки зародыша кристаллической фазы с объемом V и площадью свободной поверхности  $S_1$  может быть представлено в виде [15]

$$\Delta G_N = \Delta G_V V + \gamma_1 S_1 + (\gamma_3 - \gamma_2 + E_d) S_2, \quad (1)$$

где  $\Delta G_V = \Omega_i^{-1}[kT_s \ln(1 + \zeta) + \mu_i], \gamma_1$  — удельная свободная энергия свободной поверхности зародыша,  $\gamma_2$  и  $\gamma_3$  — удельные свободные энергии поверхности подложки и границы раздела подложка–зародыш соответственно,  $E_d$  — энергия упругой деформации в системе подложка–зародыш,  $S_2$  — площадь межфазной границы зародыш–подложка,  $\Omega_i$  — молекулярный объем материала формируемой пленки,  $\mu_i$  характеризует изменение внутренней энергии системы при формировании молекулы соединения из адсорбированных на поверхности подложки частиц,  $\zeta$  — эффективное пересыщение паровой фазы над поверхностью подложки.

Оснований предполагать наличие существенных различий в  $\zeta$  при выращивании пленок NBCO и YBCO нет, поскольку толщина пленок обоих указанных сверхпроводников возрастала примерно на 4 Å в результате воздействия десяти лазерных импульсов на соответствующие мишени, размер и форма факела, формировавшегося при испарении мишеней, практически совпадали. Появление значительного числа а-ориентированных частиц на начальной стадии роста пленки NBCO естественно связать с уменьшением разницы в удельной свободной энергии свободной поверхности для плоскостей (001) и (100)NBCO по сравнению с разницей в  $\gamma_1$  для (001) и (100) YBCO либо с изменением суммы  $\gamma_3 + E$  (см. (1)). Согласно [9], Nd может замещать Ва в элементарной ячейке NBCO, что сопровождается изменением концентрации кислорода в Си-О-цепочках. Замещение иона Ba<sup>+2</sup> ионом Nd<sup>+3</sup> может приводить к изменению удельной свободной энергии поверхности для различных кристаллографических плоскостей, и в первую очередь (001)NBCO. Если рост пленки RBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7- $\delta$ </sub> начинается с плоскостей Ва-О [16], то замещение иттрия неодимом должно приводить к изменению как  $\gamma_3$ , так и Е. Наблюдавшиеся отличия в морфологии поверхности тонких пленок NBCO и YBCO, по-видимому, обусловлены различиями в энергии активации формирования стабильных зародышей указанных материалов, для которых ось **с** перпендикулярна плоскости подложки.

При наличии на поверхности подложки ступеней высотой 1.2 nm стабильными в первую очередь становятся зародыши NBCO, для которых ось с перпендикулярна плоскости подложки. Отсутствие в объеме и в приповерхностном слое пленок NBCO, выращенных на (2 nm)YBCO/(100)LaAlO<sub>3</sub>, **a**-ориентированных зерен указывает на высокую подвижность адсорбированных частиц на поверхности растущей пленки и на низкую концентрацию микровключений вторичных фаз.

Начало падения сопротивления пленок NBCO наблюдалось при 92 К, при T = 87 К сопротивление обращалось в нуль. Приведенные значения  $T_c$  хорошо соответствуют данным, имеющимся в литературе для пленок NBCO, выращенных с использованием стехиометрических исходных мишеней [17]. Для выращивания пленок NBCO с  $T_c$  до 94 К необходимо обогащать исходную мишень барием [9]. При T = 76 К плотность критического тока для пленок NBCO превышала  $10^6$  A/cm<sup>2</sup>. Данные по температурной зависимости магнитной восприимчивости, полученные для пленок NBCO, хорошо коррелируют со значениями  $T_c$ , определенными из кривых R(T).

При  $T > 150 \,\mathrm{K}$  температурная зависимость  $\varepsilon$  для слоя STO, помещенного между электродами NBCO, хорошо соответствовала данным, полученным для слоя титаната стронция, введенного между двумя эпитаксиальными пленками YBCO [18]. При  $T < 100 \,\mathrm{K} \,\varepsilon$ для слоя STO в гетероструктуре NBCO/STO/NBCO возрастала резче, чем в случае гетероструктуры YBCO/STO/YBCO. При использовании электродов NBCO максимум на зависимости  $\varepsilon(T)$  для слоя STO становился слабо выраженным и сдвигался на 20-30 К в сторону низких температур по сравнению с его положением на соответствующей кривой, полученной в случае плоскопараллельной емкостной структуры YBCO/STO/YBCO. При T = 20 K абсолютные значения  $\varepsilon$  для слоя STO, введенного между эпитаксиальными пленками NBCO, примерно на 15% превышали данные, полученные при использовании в качестве электродов пленок ҮВСО. Указанные отличия в температурных зависимостях є для слоя STO в гетероструктурах NBCO/STO/NBCO и YBCO/STO/YBCO отражают различия в характере межфазных границ NBCO/STO и YBCO/STO.

Диэлектрическая проницаемость слоя STO при подаче на электроды NBCO напряжения смещения  $V_b = \pm 2.5$  V понижалась примерно в 3 раза при T = 32 K (рис. 5), что существенно больше, чем в случае электродов YBCO [18]. При повышении температуры зависимость  $\varepsilon$ от внешнего электрического поля ослабевала. Максимум на зависимости  $\varepsilon(V_b)$  был сдвинут в сторону отрицательных значений  $V_b$ , что обусловлено различиями в структуре и электрофизических свойствах межфазных границ NBCO/STO и STO/NBCO. Согласно полученным рентгеновским данным, параметр *с* для нижней пленки NBCO в гетероструктуре NBCO/STO/NBCO равен 11.79 Å, а для верхней пленки — 11.75 Å. Поверхность нижнего слоя NBCO, как следует из изображений, полученных с использованием микроскопа атомных сил (рис. 1, *a*), гладкая с характерными ступенями ~ 1.2 nm. В верхней пленке сверхпроводника у межфазной границы NBCO/STO, по-видимому, имелись **a**-ориентированные частицы. На это указывают данные по исследованию морфологии поверхности тонких (d = 2-10 nm) пленок NBCO, выращенных на диэлектрических подложках, и рентгеновские данные, приведенные на вставке к рис. 2.

Измеренные при различных температурах зависимости  $\varepsilon(E)$  для слоя STO в гетероструктуре NBCO/STO/NBCO хорошо описывались соотношением, успешно применяемым при анализе полевой зависимости диэлектрической проницаемости объемных монокристаллов титаната стронция при малых E [19,20],

$$\varepsilon^{-1} = \eta(T) \left[ 1 + \eta(T)^{-3} \xi E^2 \right], \qquad (2)$$

где  $\eta(T)$  — не зависящий от электрического поля параметр,  $\xi$  — не зависящая от электрического поля и температуры "константа ангармоничности". На рис. 5 показана рассчитанная с использованием соотношения (2) зависимость  $\varepsilon(E)$  для слоя STO с использованием значения  $\xi = 1.2 \cdot 10^{10} \, \mathrm{F}^{-3} \cdot \mathrm{m}^5 \cdot \mathrm{V}^{-2}$ . Указанное значение  $\xi$  было определено из наклона зависимости  $\varepsilon^{-2} d\varepsilon/dE(E)$  при  $E \rightarrow 0$ . При *E*, близких к нулю,  $\varepsilon^{-2} d\varepsilon/dE$  понижалось линейно с увеличением напряженности электрического поля. В [19] из полевой зависимости частоты мягкой моды в монокристаллах STO для  $\xi$  было получено значение, близкое к  $1 \cdot 10^{10} \, \mathrm{F}^{-3} \cdot \mathrm{m}^5 \cdot \mathrm{V}^{-2}$ . В целом наблюдается хорошее совпадение экспериментально полученных и рассчитанных значений  $\varepsilon$  для слоя STO в указанном интервале напряженности электрического поля.

Как следует из данных, представленных на рис. 4, при  $T > 200 \,\mathrm{K}$  наблюдалось резкое увеличение tg  $\delta$ с температурой для пленок STO. На рис. 5 показано изменение проводимости  $G = C\omega \operatorname{tg} \delta$  с увеличением напряженности электрического поля для пленки STO в направлении, перпендикулярном плоскости подлож-Экспериментально полученные заки ( $\omega = 2\pi f$ ). висимости проводимости слоя STO от температуры и напряженности электрического поля могут быть объяснены в рамках эмиссии Пула-Френкеля [21]. Экспериментально наблюдавшаяся зависимость проводимости слоя STO от напряженности электрического поля (рис. 5) хорошо следует полученному для эмиссии Пула-Френкеля соотношению  $\ln G \sim E^{1/2}$ . Возрастание проводимости слоя сегнетоэлектрика с увеличением напряженности электрического поля обусловлено понижением в электрическом поле барьера для заброса носителей с примесных уровней в соответствующую зону. Детальный анализ температурных и полевых зависимостей проводимости пленок (Ba,Sr)TiO<sub>3</sub>, введенных в гетероструктуру сверхпроводник/сегнетоэлектрик, приведен в [22].

Таким образом, рентгеновские данные и проведенное исследование морфологии поверхности пленок NBCO, выращенных на (2 nm)YBCO/(100)LaAlO<sub>3</sub>, позволяют утверждать, что важной предпосылкой для послойного роста пленки сверхпроводника является наличие на поверхности подложки ступеней высотой ~ 1.2 nm. Свободный от микроотверстий слой (400 nm)STO может быть выращен эпитаксиально на поверхности пленки (200 nm)NBCO. Использование эпитаксиальных пленок NBCO вместо пленок YBCO в качестве электродов в плоскопараллельной конденсаторной структуре сверхпроводник/сегнетоэлектрик/сверхпроводник позволяет существенно усилить зависимость эффективной диэлектрической проницаемости слоя сегнетоэлектрика от напряженности внешнего электрического поля.

Финансовая поддержка для выполнения данной работы была получена из проекта 98041 "Комбинация", проводимого в рамках направления "Сверхпроводимость", проекта РФФИ № 98-02-18222 и проекта TFR N 240-97-382.

### Список литературы

- I.S. Gergis, J.T. Cheung, T.H. Trinh, E.A. Sovero, P.H. Kobrin. Appl. Phys. Lett. 60, 2026 (1992).
- [2] J.P. Hong, J.S. Lee. Appl. Phys. Lett. 68, 3034 (1996).
- [3] F.W. Nan Keuls, R.R. Romanofsky, D.Y. Bohman, M.D. Winters, F.A. Miranda, C.H. Mueller, R.E. Treece, T.V. Rivkin, D. Galt. Appl. Phys. Lett. **71**, 3075 (1997).
- [4] C.M. Jackson, J.H. Kobayashi, A. Lee, C. Pettiette-Hall, J.F. Burch, R. Hu. Microwave Opt. Technol. Lett. 5, 722 (1992).
- [5] O.G. Vendik, L.T. Ter-Martirosyan, A.I. Deduk, S.F. Karmanenko, R.A. Chakalov. Ferroelectrics 144, 33 (1993).
- [6] Yu.A. Boikov, Z.G. Ivanov, A.N. Kiselev, E. Olsson, T. Claeson. J. Appl. Phys. 78, 4591 (1995).
- [7] Yu.A. Boikov, Z.G. Ivanov, A.L. Vasiliev, I. Pronin, E. Olsson, T. Claeson. Appl. Phys. Lett. 67, 2708 (1995).
- [8] J.G. Lin, C.Y. Huang, Y.Y. Xue, C.W. Chu, X.W. Cao, J.C. Ho. Phys. Rev. B51, 12 900 (1995).
- [9] M. Badaye, J.G. Wen, K. Fukushima, N. Koshizuka, T. Morishita, T. Nishimura, Y. Kido. Supercond. Sci. Technol. 10, 825 (1997).
- [10] L.A. Tietz, C.B. Carter, D.K. Lathrop, S.E. Russek, R.A. Buhrman, J.R. Michael. J. Mater. Res. 4, 1072 (1989).
- [11] F.W. Lytle. J. Appl. Phys. 35, 2212 (1964).
- [12] Yu.A. Boikov, V.A. Danilov, E. Carlsson, D. Erts, T. Claeson. Physica B, in press.
- [13] T. Shimizu, H. Nonaka, K. Arai. Appl. Phys. Lett. 59, 600 (1991).
- [14] Handbook of Chemistry and Physics / Ed. R.C. Weast. 59th edition. CRC Press Inc. (1978–1979). P. E-81. Florida (1979).
- [15] Ю.А. Бойков, З.Г. Иванов, Е. Олсон, В.А. Данилов, Т. Клаесон, М. Щеглов, Д. Эртс. ФТТ **37**, *3*, 880 (1995).
- [16] A.L. Vasiliev, G. Van Tendeloo, A. Amelincks, Yu.A. Boikov, E. Olsson, Z. Ivanov. Physica C244, 373 (1991).
- [17] M. Badaye, F. Wang, Y. Kanke, K. Fukushima, T. Morishita. Appl. Phys. Lett. 66, 2131 (1995).
- [18] Yu.A. Boikov, T. Claeson. J. Appl. Phys. 81, 3232 (1997).
- [19] J.M. Worlock, P.A. Fleury. Phys. Rev. Lett. 19, 1176 (1967).

- [20] G. Rupprecht, R.O. Bell, B.D. Silverman. Phys. Rev. 123, 97 (1961).
- [21] J.R. Yeargan, H.L. Taylor. J. Appl. Phys. 39, 5600 (1968).
- [22] Yu.A. Boikov, T. Claeson. Supercond. Sci. Technol., in press.